

## **江苏长电科技股份有限公司**

### **2021 年度为全资子公司融资提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示:**

1、被担保人名称:长电科技(宿迁)有限公司、长电科技(滁州)有限公司、江阴长电先进封装有限公司、长电国际(香港)贸易投资有限公司、JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED、星科金朋半导体(江阴)有限公司、STATS CHIPPAC PTE. LTD.。

2、对外担保累计金额:截止 2020 年 12 月 31 日,本公司为全资子公司融资及其他业务累计担保余额为 57.09 亿元人民币,无对外担保。

3、反担保情况:无

4、对外担保逾期的累计数量:无

#### **一、担保情况概述**

为满足全资子公司 2021 年度经营发展需要,公司拟提供总额度不超过 100 亿元人民币的担保,担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、抵质押担保、融资租赁担保、经营性租赁担保等;子公司被担保业务方式包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现、应付账款保函、海关税费保函、应收账款保理、国内证开证及议付、国际证开证及押汇等,具体额度如下:

- 1、对长电科技(宿迁)有限公司担保不超过 6 亿元人民币;
- 2、对长电科技(滁州)有限公司担保不超过 2 亿元人民币;
- 3、对江阴长电先进封装有限公司担保不超过 10 亿元人民币;

- 4、对长电国际（香港）贸易投资有限公司担保不超过 7 亿元人民币；
- 5、对 JCET STATS CHIPAC KOREA LIMITED 担保不超过 15 亿元人民币；
- 6、对星科金朋半导体（江阴）有限公司担保不超过 20 亿元人民币；
- 7、对 STATS CHIPAC PTE. LTD.担保不超过 40 亿元人民币。

201 年 4 月 27 日，公司召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度为全资子公司融资提供担保的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。

## 二、担保对象简介

### 1、长电科技（宿迁）有限公司

为本公司全资子公司，注册资本 25,000 万元人民币，主营研制、开发、生产、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置。

2020 年末总资产为 128,440.24 万元人民币；净资产为 31,079.01 万元人民币；2020 年营业收入 95,592.43 万元人民币；净利润 10,711.16 万元人民币。（以上数据未经审计）

### 2、长电科技（滁州）有限公司

为本公司全资子公司，注册资本 30,000 万元人民币，主营研制、开发、生产、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置。

2020 年末总资产为 122,507.90 万元人民币；净资产为 85,885.19 万元人民币；2020 年营业收入 118,423.26 万元人民币；净利润 20,475.80 万元人民币。（以上数据未经审计）

### 3、江阴长电先进封装有限公司

为本公司全资子公司，母公司持股 96.488%，全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司持股 3.512%的中外合资企业，注册资本 5,100 万美元，主营半导体芯片凸块及封装测试产品。

2020 年末总资产为 369,503.24 万元人民币；净资产为 181,788.49 万元人民币；2020 年营业收入 199,545.72 万元人民币；净利润 32,070.73 万元人民币。（以上数据未经审计）

#### 4、长电国际（香港）贸易投资有限公司（下称“长电国际”）

为本公司在香港设立的全资子公司，注册资本 24,800 万美元，主营进出口贸易。

2020 年末总资产为 219,872.18 万元人民币；净资产为 169,631.44 万元人民币。（以上数据未经审计）

#### 5、JCET STATS CHIPAC KOREA LIMITED

为本公司全资子公司长电国际在韩国设立的全资子公司，主营高端封装测试产品，主要进行高阶 SiP 产品封装测试。

2020 年末总资产为 78,798.73 万美元，净资产为 28,890.83 万美元；2020 年营业收入 123,450.79 万美元；净利润 5,833.49 万美元。（以上数据未经审计）

#### 6、STATS CHIPAC PTE. LTD.

为本公司间接持股 100% 的子公司，主营半导体封装设计、凸焊、针测、封装、测试和布线解决方案提供商，全球集成电路封测外包公司。

2020 年末总资产为 195,807.06 万美元，净资产为 84,754.82 万美元；2020 年营业收入 134,103.51 万美元，净利润 2,293.99 万美元。（以上数据未经审计）

#### 7、星科金朋半导体（江阴）有限公司

为本公司间接全资子公司，注册资本 32,500 万美元，主营集成电路研究、设计；BGA、PGA、CSP、MCM 等先进封装与测试，并提供相关的技术服务。

### 三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过而在以前年度签订的协议外，尚未签订具体担保协议，2021 年度公司将根据以上公司的申请，视资金需求予以安排。

#### **四、董事会意见**

本公司现有担保均为向下属全资子公司提供的担保，该等担保均是为支持各下属公司的生产经营发展，公司对该等公司的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内。

#### **五、对外担保累计金额及逾期担保的数量**

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司为全资子公司累计担保余额为 57.09 亿元人民币，无对外担保。

本公司无逾期担保。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日